

证券代码：688627

证券简称：精智达

深圳精智达技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场调研 ☐ 电话会议 ☒ 其他：券商策略会
参与单位	大成基金、宝盈基金、富国基金、信达澳亚、南方基金、博时基金、平安基金、诺安基金、数联投资、施罗德、Hao Capital、东方阿尔法、中信建投自营、中天国富证券、中海基金、云溪基金、全天候投资、创富兆业、前海联合基金、前海道谊、华美投资、南土资产、国信自营、国投瑞银、国泰基金、国联基金、国证资管、富荣基金、广发资管、思瑞投资、恒生前海、惠通基金、招商自营、招商资管、智诚海威、江信基金、泓澄投资、浙商资管、涌津投资、淡水泉、源乘投资、爱建资管、笃诚投资、英大证券、财信证券、金之灏基金、万和证券、金信基金、金元证券
时间	2025 年 6 月 24 日
地点	深圳市福田区福华三路 138 号四季酒店
接待人员姓名	董事会秘书：彭娟
投资者关系活动主要内容介绍	1.请公司介绍一下产品情况？ 答：公司 DRAM 老化测试修复设备、MEMS 探针卡等产品出货量持续提升，保持国产设备供应商中的领先地位；具备晶圆裸片测试功能、旨在提升客户研发设计和品质验证效率的存储器通用测试验证机获得批量订单并且实现验收，自主

	研发测试机平台已经获得客户认可。 在新型显示器件检测设备领域，公司在产品结构与市场突破方面取得新进展：率先取得国内 AMOLED G8.6 高世代线关键检测设备订单；持续取得 Micro LED 领域相关检测设备订单，加强在微显示领域业务布局；首次取得 AR/VR 终端头部厂商的订单，在海外市场扩展方面取得重大进展；成功研发高分辨率成像式色度仪器并向市场推广，产品结构得到进一步拓展和完善。 2.请介绍公司新产品的研发进展？ 答：公司将持续推动满足针对先进封装测试要求的升级版 CP 测试机、高速 FT 测试机等核心测试设备研发及客户验证工作；高速 FT 测试机专用 ASIC 芯片（最高可实现 9Gbps 信号输出与校准）已获得客户认可，标志着公司在高速芯片测试领域取得重要突破。 3.请公司介绍一下先进封装设备领域的计划？ 答：公司将积极拓展 MEMS 探针卡产品线，启动针对先进封装的分选机、探针台等测试设备的研发准备工作，公司已于 2024 年 12 月成立全资子公司南京精智达技术有限公司从事先进封装设备研发与生产，进一步完善公司向客户提供的系统解决方案。 4. 公司在 HBM 领域有何布局？ 公司根据新技术和新应用在半导体存储器和 AI 算力芯片方面的新要求，配合客户业务稳步推进开发针对如 KGSD、HBM 等基于 2.5D 和 3D 新一代半导体封装技术的测试技术和设备，提高和完善 DRAM 测试领域系统化全站点服务能力。
--	---

	5.公司后续业绩增长预期如何？ 公司以 2023 年营业收入、2023 年半导体业务营业收入为业绩基数，依据 2025 年员工持股计划及限制性股票激励计划，对各考核年度营业收入、半导体业务营业收入相对业绩基数的增长率开展考核。业绩考核目标为 2025 年营业收入增长率不低于 60% 且半导体业务营业收入增长率不低于 500%；2026 年营业收入增长率不低于 110% 且半导体业务营业收入增长率不低于 800%。建议持续关注公司目标达成节点。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 6 月 24 日